

偏心 Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体生长 S-L 界面形状的数值模拟

王培林 邓开举 张国艳 周士仁

(哈尔滨工业大学控制工程系 哈尔滨 150001)

摘要 用三维数值模拟方法研究了偏心 Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体生长系统 S-L 界面附近的温度分布。考察了偏心程度、安瓿与炉膛直径相对大小以及炉膛温度分布等对倾斜 S-L 界面的影响情况。结果表明, 偏心温度场可提高晶片上一较大区域内的横向组分均匀性。 $\varphi=0, \pi$ 面上的等温线分布可作为确定切片倾角的依据。

PACC: 6150C, 4410, 0260

1 引言

用经典的垂直 Bridgman 法生长 Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体时, 安瓿中从熔体到晶体热导率急剧下降, 同时为承受 Hg 蒸气的高压而采用很厚的石英安瓿, 使固液(S-L)界面前沿的热量有很大一部分是从熔体经安瓿壁向外传输。因而产生了沿径向的温度梯度, 引起 S-L 界面弯曲。另外一些因素, 如石英对红外波的透射、辐射视角 α 和 β 的相对大小及生长速度等也影响着界面形状。象 Hg_{1-x}Cd_xTe 这种溶质分凝很严重的赝二元合金, S-L 界面形状的微小变化都会给晶体组分分布带来很大的影响。以至于目前组分均匀性成为制约 Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体质量的关键之一。一些改进的 Bridgman 方法都着眼于获得平坦或略呈凸形的 S-L 界面。凸形 S-L 界面有利于消除安瓿壁处的杂散晶核, 改善晶粒择优生长条件、提高单晶率。而平坦 S-L 界面即是等温面又是等浓度面, 界面前沿径向温度梯度趋于零, 消除了此处的热对流, 使流态变成平面层流, 从而提高径向组分均匀性^[1,2]。可用边界层扩散理论处理轴向溶质分布, 而不存在径向分凝问题。在多种改进方法中, Bagai^[3]的使安瓿轴线平行偏离炉膛轴线而构成的非对称温度场方法(以下简称偏心 Bridgman 法)以简便为特征, 实验结果也比较理想。

本文用数值模拟方法进一步研究了这种技术。至今为止, 关于 Bridgman 系统的数值模拟问题还仅限于一维或二维计算^[4], 而偏心 Bridgman 系统不具备轴对称性, 因此数值模拟属三维计算问题。

王培林 男, 1960 年生, 讲师(在职攻读博士), 近年来从事晶体生长及其数值模拟研究工作
1994 年 7 月 27 日收到初稿, 1995 年 1 月 2 日收到修改稿

2 计算模型

偏心 Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体生长与经典垂直 Bridgman 法基本相同, 只是将安瓿轴线平行偏离炉膛轴线。装好材料的安瓿以拉晶速度 v_g 从热区向冷区移动, 在绝热区熔体凝固结晶。当整个安瓿全部进入冷区后, 晶体生长结束, 如图 1(a) 所示。

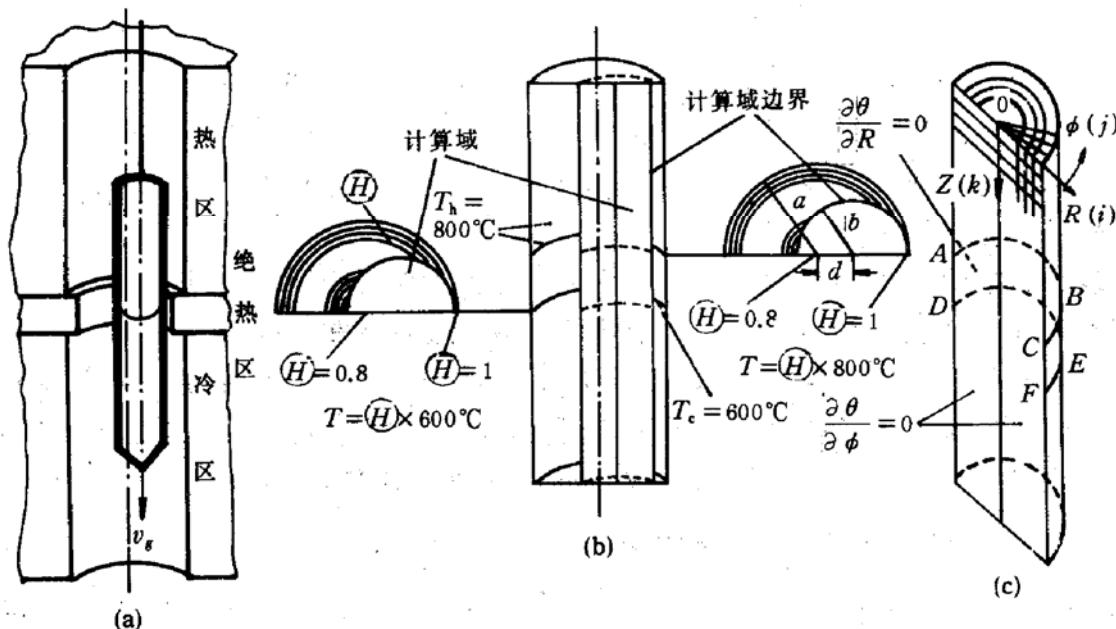


图 1 (a) 偏心 Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体生长系统
(b) 计算域 (c) 绝热区上、下边界温度分布确定方法示意图

根据以往的计算结果^[5,6], 如果 Bridgman 炉热区温度 $T_h=800^\circ\text{C}$ 、冷区温度 $T_c=600^\circ\text{C}$, 则绝热区内等温面近似为平行平面。可以想象, 在这样的温度场中, 是否使安瓿轴线偏离炉膛中心位置, 对 S-L 界面形状不会带来明显的影响。按照 Dakhoul 的数值模拟结果^[7], 降低冷区温度到一定值以后, 可以使 Bridgman 系统 S-L 界面由凹形变成凸形, 即绝热区内的温度分布为中心低、边缘高, 等温面呈凸形。因此, 计算中这样来考虑图 1(a) 中炉膛的温度分布: 适当降低冷区温度, 使绝热区内的温度分布处于中心低、边缘高的状态。同时绝热区上边界及以上区域炉膛壁温度为 $T_h=800^\circ\text{C}$, 绝热区下边界炉膛壁温度为 $T_c=600^\circ\text{C}$ 。

2.1 确定炉膛内温度分布

根据以上分析, 用一维无量纲热传导方程

$$\frac{d^2\Theta}{dR'^2} + \frac{1}{R'} \frac{d\Theta}{dR'} = 0 \quad (1)$$

来确定图 1(b) 所示的绝热区上、下两边界等距同心圆上的温度值。其中 $\Theta=T/T_f$, $R'=r'/a$, T 是温度, T_f 为炉膛壁温度。绝热区上边界及热区以上: $T_f=T_h=800^\circ\text{C}$, 绝热区下边界: $T_f=T_c=600^\circ\text{C}$, a 为炉膛半径, r' 为径向坐标, 坐标系原点选在轴线上。

2.2 计算域内的无量纲热传输方程及边界条件

计算域如图 1(c) 所示, 不考虑安瓿本身的影响。系统关于炉膛轴线和安瓿轴线所在平面对称, 故计算域取半个圆柱体, 坐标选取如图中所示, 并假设整个计算域有一致的导热系数 k 。

柱坐标中只有沿 z 轴方向运动 ($v_r = v_\phi = 0, v_z = v_g$) 的介质, 定常状态下的热传输方程为^[8]:

$$\frac{k}{\rho C_p} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right] - v_g \frac{\partial T}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

式中 k 是导热系数, ρ 是密度, C_p 是比热, v_g 是拉晶速度. 用 $k/\rho C_p b$ 对速度进行无量纲化, 用 π 对坐标 φ 进行无量纲化, 用计算域半径 b 对坐标 (r, z) 进行无量纲化, 则得到无量纲热传输方程:

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial R^2} + \frac{1}{R} \frac{\partial \theta}{\partial R} + \frac{1}{(\pi R)^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial \Phi^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial Z^2} - P_e \frac{\partial \theta}{\partial Z} = 0 \quad (3)$$

式中 $P_e = v_g \rho C_p / k, R = r/b, \Phi = \varphi/\pi, Z = z/b, \theta = (T - T_c) / (T_h - T_c)$. 上式就是计算域内的温度方程.

轴线到炉膛壁之间, 根据计算需要可生成一定数量的等距同心圆. 这些等距同心圆上的温度值由方程(1)确定. 图 1(c)中 ABC、DEF 的温度边界条件, 可根据这些与计算域边界相交的等距同心圆的温度值来按 I 类边界条件给出, 如图 1(b)所示. 由于重点考察 S-L 界面附近的温度分布情况, 因此计算域端头取齐, 并与热区、冷区一起均按 I 类边界条件处理. 绝热区长度取 $2b$, 热区和冷区长度均取 $4b$. 绝热区边界(ACFDA 柱面)按热流为零条件处理成 $\frac{\partial \theta}{\partial R} = 0, \Phi = 0, 1$ 平面边界条件按关于 Φ 对称条件处理成 $\frac{\partial \theta}{\partial \Phi} = 0$.

3 计算结果与分析

按上述方程及边界条件, 在计算域内进行数值计算. 沿 R, Φ, Z 方向建立网格: $i=1 \sim 20, j=1 \sim 11, k=1 \sim 100$. 绝热区内部有 4000 多个体元. 用有限差分方法对方程(3)进行离散化处理, 然后对每个体元逐一反复计算. 大致计算顺序是: 先按方程(1)计算炉膛内温度分布, 据此结果确定计算域边界条件, 再对内部节点赋初值, 然后进行 $\Phi=0$ 面上体元的计算, 直到 $\Phi=1$ 面为止. 当多次迭代计算后, 比较同一节点上前后两次温度值, 若满足精度要求就可结束计算, 最后生成图形文件.

关于柱坐标系中场量三维数值模拟结果的表现形式, 还是个有待于深入探讨的问题. 对于温度场, 若在同一图中给出 $\theta = 0.1, 0.2, \dots, 0.9$ 每个等温面立体图, 则多个等温面会交叠在一起, 使结果混乱难以分辨. 另外, 立体图形反映等温面比较形象, 但若定量反映其倾斜或弯曲, 却不如剖面上等温线准确. 我们是这样来处理计算结果的: 用 $\varphi = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi, \pi$ 四个剖面上的等温线联合反映温度分布情况, 如图 2 所示. 由于主要研究 S-L 界面, 故只给出绝热

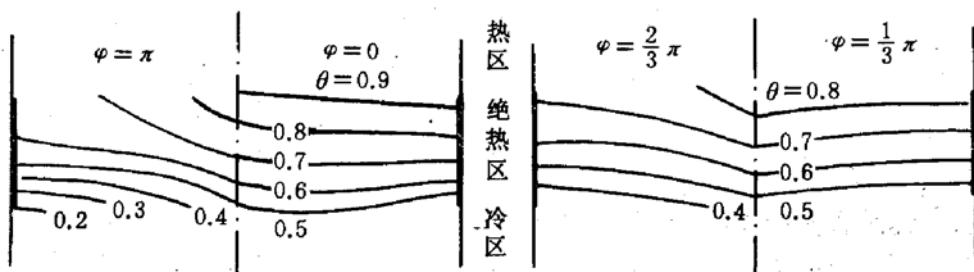


图 2 特性参数为 $a:b=2:1, d=b, P_e=0.2, \Theta=0.8 \sim 1$ 时的温度分布

区内的温度分布。等温线曲率反映了径向温度梯度，等温线间的疏密反映了轴向温度梯度， $\theta = 0.5$ 的等温面为 S-L 界面。因为每一等温面代表一个可能的界面，故实际进行晶体生长时，亦可通过调整冷区热区温度而使 S-L 界面与某一特定 θ 值等温面相对应。部分结果还给出了 S-L 界面立体图。重点考察了安瓿中心轴线偏离炉膛中心轴线的距离 d 、炉膛温度分布 Θ 、炉膛半径与安瓿半径比 $a:b$ 以及无量纲拉晶速度 P_e 对 S-L 界面的影响。图 3~图 5 为 $P_e=0.5$ 、 $\Theta=0.8\sim1$ ，几何参数 $a:b$ 及 d 不同时所计算的 S-L 界面。下面对计算结果作一归纳分析。

(1) 比较图 3 与图 4，它们所对应的特性参数区别只在于偏心距离 d 。图 4 中的 S-L 界面

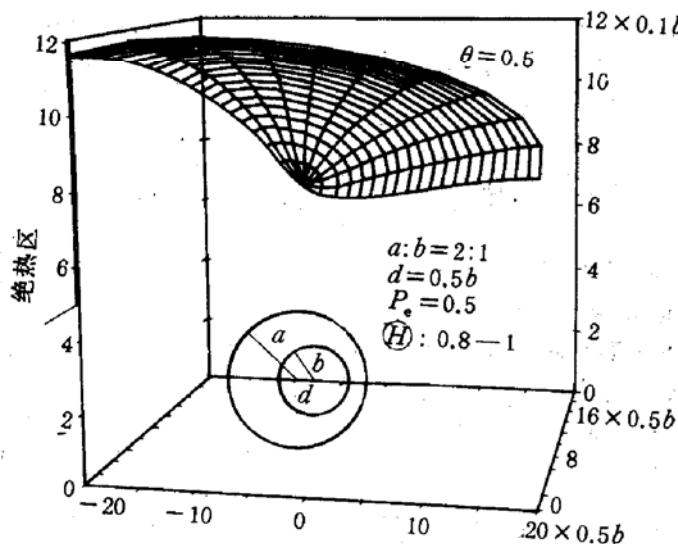


图 3 $a:b=2:1, d=0.5b$ 时的 S-L 界面

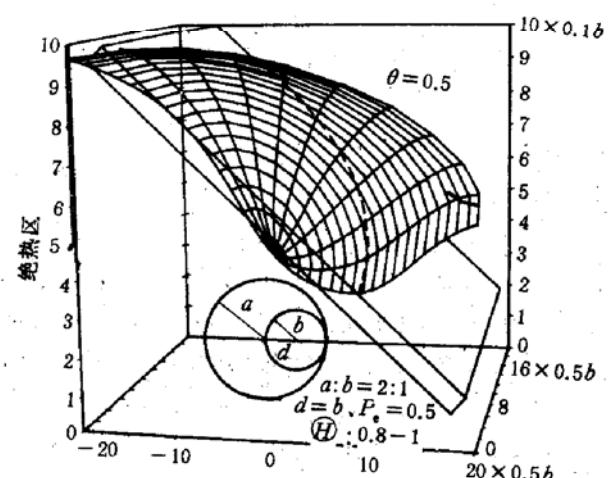


图 4 $a:b=2:1, d=b$ 时的 S-L 界面

倾斜现象比图 3 严重，这说明 d 愈大，S-L 界面倾斜愈明显。 $\Theta=0.8\sim1$ 代表炉膛内温度分布的范围：热区和绝热区上、下边界轴线处无量纲温度为 0.8，炉膛壁处为 1，如图 1(b) 所示。

(2) 比较图 4 和图 5 可知，炉膛与安瓿半径相差较大者，其 S-L 界面倾斜较明显。这说明适当增大炉膛直径，并尽可能使安瓿靠近边缘位置，才能有效利用偏心温度场技术。

(3) 图 6 将四种情况下的 $\theta=0.5$ 等温线集中在一起。从曲线 1、2、3 可看出，随着无量纲拉晶速度增大，S-L 界面逐渐向下移动，更加靠近冷区。这与以往的计算结果^[6,9]相同。

(4) 比较图 6 中 2,4 两条曲线，可见炉膛中温度分布对 S-L 界面弯曲和倾斜影响很大。炉膛径向温度梯度愈大，S-L 界面倾斜愈明显。

(5) 全部模拟结果均表明，偏心 Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe 晶体生长时，S-L 界面呈倾斜状态，同时尚有下凹现象，但下凹谷点偏离中心位置。如果按图 4 中所示的倾斜平面对样品切片，能使晶片上一较大区域内的横向组分均匀性得到改善，而这是经典 Bridgman 方法所不能办到的。模拟结果中提供的 $\varphi=0$ 与 $\varphi=\pi$ 面上的等

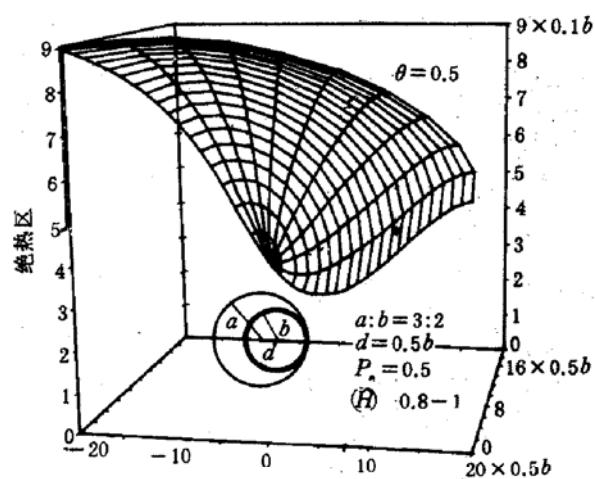


图 5 $a:b=3:2, d=0.5b$ 时的 S-L 界面

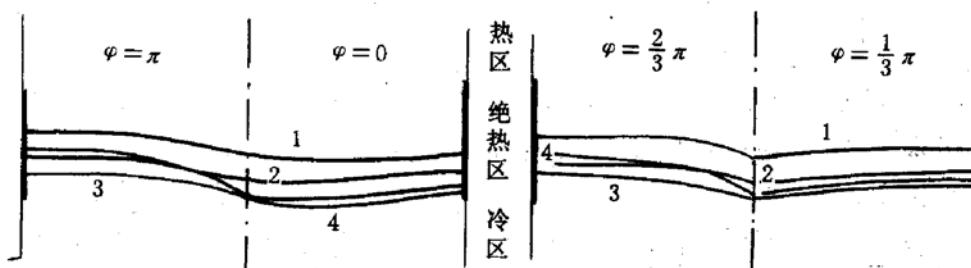


图 6 四种不同情况下的 S-L 界面

1. $a : b = 2 : 1, d = 0.5b, P_e = 0, \Theta = 0.8 \sim 1$; 2. $a : b = 2 : 1, d = 0.5b, P_e = 0.5, \Theta = 0.8 \sim 1$;
3. $a : b = 2 : 1, d = 0.5b, P_e = 1, \Theta = 0.8 \sim 1$; 4. $a : b = 2 : 1, d = 0.5b, P_e = 0.5, \Theta = 0.6 \sim 1$.

温线可以作为确定切片角度的依据。

参 考 文 献

- [1] P. Capper, J. J. G. Gosney and C. L. Jones, *J. Crystal Growth*, 1984, **70**: 356.
- [2] C-H. Su, S. L. Lehoczky and F. R. Szofran, *J. Crystal Growth*, 1991, **109**: 392.
- [3] B. Antar, University of Tennessee Space Institute. Private Communication, 1988.
- [4] 王培林, 魏科, 张国艳等, *材料研究学报*, 1994, **8**(5): 411.
- [5] T-W. Fu and W. R. Wilcox, *J. Crystal Growth*, 1980, **48**: 416.
- [6] 王培林, 魏科, 周士仁, *半导体学报*, 1994, **15**(9): 596.
- [7] Y. M. Dakhoul, R. Farmer, S. L. Lehoczky et al., *J. Crystal Growth*, 1988, **86**: 49.
- [8] 陈景仁, *流体力学及传热学*, 北京: 国防工业出版社, 1984.
- [9] 王培林, 刁凤斌, 魏科等, *哈尔滨工业大学学报*, 1994, **26**(6): 50.

Numerical Simulation of S-L Interface Shape of Asymmetrical Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe Crystal Growth

Wang Peilin, Deng Kaiju, Zhang Guoyan and Zhou Shiren

(Department of Control Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin, 150001)

Received 27 July 1994, revised manuscript received 2 January 1995

Abstract The temperature distribution around the S-L interface of the asymmetrical Bridgman-Hg_{1-x}Cd_xTe crystal growth system has been studied by using the three-dimensional numerical analysis method. The effects of asymmetrical degree, the size of the ampoule compared with the furnace and the temperature distribution in the furnace on the inclined S-L interface, etc., have been investigated. The results show that the asymmetrical temperature field is able to increase the radial compositional uniformity in a large area. $\varphi = 0$ and the isotherm distribution on the π plane can be used as basis in position determination of the cut slice.